

Page 1 of 7

新聞稿

即時發布

## 香港科技园公司與微電子企業杰平方半導體簽署合作備忘錄 共同推動香港微電子產業發展

### 杰平方半導體宣布啟動香港首間碳化硅 (SiC) 先進垂直整合晶圓廠項目 計劃落戶科學園設立研發中心 實行自主研發及生產第三代半導體芯片

- 科技园公司與杰平方半導體的合作是由創新科技及工業局和引進重點企業辦公室共同推動，以持續完善香港創科生態圈以及推動「新型工業化」。
- 科技园公司與杰平方半導體簽署合作備忘錄，共同推動香港微電子產業發展，有助杰平方半導體在香港建設第三代半導體碳化硅 8 寸先進垂直整合晶圓廠項目正式啟動，共同推進香港微電子生態圈及第三代半導體芯片產業的發展。
- 杰平方半導體預計總投資額約港幣 69 億元，按規劃通線、擴產，於 2028 年達到年產量 24 萬片碳化硅晶圓，帶動年產值超過港幣 110 億元，並創造超過 700 個就業職位。

(香港，2023 年 10 月 13 日) 由創新科技及工業局和引進重點企業辦公室共同推動，香港科技园公司 (科技园公司) 與微電子企業杰平方半導體 (上海) 有限公司 (杰平方半導體) 簽署合作備忘錄，在科學園設立以第三代半導體為主的全球研發中心，並投資開設香港首間碳化硅 (SiC) 8 寸先進垂直整合晶圓廠，共同推進香港微電子生態圈及第三代半導體芯片產業的發展。

香港特區政府創新科技及工業局去年公布的《香港創科發展藍圖》中，明確指出應加強支持具策略性的先進製造產業發展，譬如半導體芯片，促進香港「新型工業化」的發展。作為全球最大的半導體進出口市場之一，香港更是位處大灣區核心位置，擁有具大潛力能成為全球半導體供應鏈和價值鏈的關鍵樞紐。

創新科技及工業局局長孫東教授表示：「今次科技园公司和杰平方半導體的合作項目，是香港歷史上設立的第一家具規模的半導體晶圓廠，反映本屆特區政府正在將『新型工業化』、聚焦半導體芯片前沿領域的發展從口號、從規劃轉化為實際行動。杰平方半導體亦計劃積極培訓本地人才，提升本港在科技方面的人力資源素質和競爭力。此外，項目還將帶動相關產業的發展，

Page 2 of 7

包括半導體設備製造商、材料供應商、測試服務提供者等，從而提升香港在全球半導體產業價值鏈中的地位。」

是次科技园公司與杰平方半導體的合作是由創新科技及工業局和引進重點企業辦公室共同推動，以持續完善香港創科生態圈以及推動「新型工業化」。在創新科技及工業局局長孫東教授、引進重點企業辦公室主任容偉雄先生、創新科技及工業局副局長張曼莉女士、香港科技园公司主席查毅超博士及杰平方半導體（上海）有限公司董事長俎永熙博士見證下，香港科技园公司行政總裁黃克強先生與杰平方半導體（上海）有限公司聯合總經理朱東園先生簽署合作備忘錄。

香港科技园公司主席查毅超博士表示：「香港的微電子產業發展潛力龐大，是次杰平方半導體計劃落戶科學園，推動香港生產自主研發的第三代半導體芯片，將先進的電動車芯片設計、製造流程和半導體產品開發的核心技術與專業知識帶入香港，為本港微電子產業發展的重要里程碑。作為香港的旗艦創科平台之一，我們提供高水平的基建和配套、龐大的合作夥伴網絡，將繼續推動本港微電子的研發實力，鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。」

杰平方半導體（上海）有限公司董事長俎永熙博士表示：「非常感謝香港創新科技及工業局、香港科技园，對本專案的高度重視和支持！簽署合作備忘錄標誌著我們正式啟動第三代半導體『碳化硅 8 寸先進垂直整合晶圓廠』的項目計劃。該項目的總投資額預約港幣 69 億元，按規劃通線、擴產，於 2028 年達到年產量 24 萬片碳化硅晶圓，帶動年產值超過港幣 110 億元，並創造超過 700 個本地及吸引國際專業人士來港的就業職位。包括晶片及微電子產品設計、微電子模組化及生產流程發展等，以進一步推動香港多元經濟發展。項目將在香港迎來蓬勃發展，助力早日完成新能源車供應鏈國產化的宏圖偉業，並帶動香港地區半導體產業的長期發展與繁榮！」

杰平方是聚焦車載晶片研發的晶片設計企業，杰平方致力於滿足中國汽車產業對國產自主車載晶片的旺盛需求，主要面向電能轉換、通信等領域，提供高性能碳化硅（SiC）晶片、車載信號鏈晶片及車載模擬片等前沿產品。其卓越的硅基功率晶片技術更可應用到電動車等相關應用，亦可優化相關的基礎設施的發展，例如充電站、智慧電網和能源儲存等。

科技园公司一直致力推動香港的「新型工業化」進程，打造世界領先的微電子生態圈。現時科技园已建設了完善的微電子硬件設施，包括傳感器封裝集成實驗室（Sensor Lab）、異構系統整合實驗室（HI Lab）及硬件實驗室（Hardware Lab），這些設施能支援芯片相關的設備和系

Page 3 of 7

統以至產品的設計、原型製作及試點生產的完整流程。位於元朗創新園的微電子中心預計於 2024 年啓用，將配合科技园公司多項基礎建設，加速微電子研發及中試，為上下游企業及產業鏈創造機遇。

科技园公司的微電子生態圈發展蓬勃，目前，共有超過 200 間從事微電子產業相關的公司，杰平方半導體落戶香港，將產生更大的協同效應及知識交流。現時本港有五所大學的排名位列全球首 100 名，當中更有逾 100 名大學研究人員從事微電子領域研究，能為行業提供相關的專業人才，推動第三代半導體的研發。香港特區政府在今年的財政預算案更宣布打算設立一所微電子研發院，強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到 N」的科研成果轉化，促進產業發展。



圖一：在創新科技及工業局局長孫東教授（後排中間）、引進重點企業辦公室主任容偉雄先生（後排左一）、創新科技及工業局副局長張曼莉女士（後排右一）、香港科技园公司主席查毅超博士（後排左二）、杰平方半導體（上海）有限公司董事長俎永熙博士（後排右二）見證下，香港科技园公司行政總裁黃克強先生（前排左）與杰平方半導體(上海)有限公司聯合總經理朱東園先生（前排右）共同簽署合作備忘錄。



圖二：一眾嘉賓見證香港科技园公司與內地微電子企業杰平方半導體（上海）有限公司簽署合作備忘錄，共同推動香港微電子生態圈及第三代半導體芯片產業的發展，包括：

- 香港特別行政區創新科技及工業局局長孫東教授（左十一）
- 香港特別行政區引進重點企業辦公室主任容偉雄先生（左九）
- 香港特別行政區創新科技及工業局副局長張曼莉女士（右七）
- 香港科技园公司主席查毅超博士（左十）
- 杰平方半導體（上海）有限公司董事長俎永熙博士（右九）
- 香港科技园公司行政總裁黃克強先生（左八）
- 寧德時代新能源科技股份有限公司副董事長李平先生（右八）
- 香港高通資本集團董事長馬志剛先生（右六）
- 中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司董事總經理王蓓蓓女士（右五）
- 北京屹唐長厚創業投資基金管理有限公司基金合夥人謝宏偉先生（右一）
- 小米集團產業投資部投資總監張凌捷（右二）
- 海南柏睿投資有限公司基金合夥人王利民先生（左四）
- 杰平方半導體（上海）有限公司聯合總經理司徒道海先生（左五）
- 杰平方半導體（上海）有限公司聯合總經理朱東園先生（右四）
- 杰平方半導體（上海）有限公司財務長吳曼寧女士（右三）

Page 5 of 7



圖三：創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示：「今次科技园公司和杰平方半導體的合作項目，是香港歷史上設立的第一家具規模的半導體晶圓廠，反映本屆特區政府正在將『新型工業化』、聚焦半導體芯片前沿領域的發展從口號、從規劃轉化為實際行動。杰平方半導體亦計劃積極培訓本地人才，提升本港在科技方面的人力資源素質和競爭力。」



圖四：香港科技园公司主席查毅超博士表示：「是次杰平方半導體計劃落戶科學園，推動香港生產自主研發的第三代半導體芯片，將先進的電動車芯片設計、製造流程和半導體產品開發的核心技術與專業知識帶入香港，為本港微電子產業發展的重要里程碑。」



圖五：杰平方半導體（上海）有限公司董事長俎永熙博士表示：「非常感謝香港創新科技及工業局、香港科技園，對本專案的高度重視和支持！簽署合作備忘錄標誌著我們正式啟動第三代半導體『碳化硅 8 寸先進垂直整合晶圓廠』的項目計劃。」

###

### 關於香港科技園公司

香港科技園公司（科技園公司）成立逾 20 年，致力將香港發展成為國際創新科技中心，積極讓本地及全球創新者邁向成功，幫助他們在未來獲得更大成就。科技園公司在香港建立了蓬勃的創科生態圈，過去共支援超過 10 間獨角獸企業，亦匯聚超過 13,000 名研究人才，以及超過 1,400 間從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展的科技公司。

科技園公司於 2001 年成立，一直大力吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為創業家的創科路上提供全方位支援。我們建立的創科生態圈持續成長，足跡遍及全港，包括沙田的香港科學園、九龍塘的創新中心，以及位於大埔、將軍澳及元朗的創新園。三個創新園結合創新元素，朝著香港新型工業化發展方向，重點帶動先進製造業、微電子業及生物科技等行業，重新定位新世代工業。

科技園公司透過提供基礎設施、支援服務、專業知識及合作夥伴網絡，致力令創新科技成為香港的新經濟動力，鞏固香港國際創新科技中心的地位，同時借助位處大灣區核心的優勢，成為引領創科發展的重要引擎。

Page 7 of 7

更多有關香港科技園公司的詳情，請瀏覽 [www.hkstp.org](http://www.hkstp.org)。

### **關於杰平方半導體（上海）有限公司**

杰平方半導體（上海）有限公司（以下簡稱“杰平方”）是聚焦車載晶片研發的晶片設計企業，杰平方現有晶片設計總部位於上海。杰平方致力於滿足中國汽車產業對國產自主車載晶片的旺盛需求，主要面向電能轉換、通信等領域，提供高性能碳化矽（SiC）晶片、車載信號鏈晶片及車載模擬片等前沿產品。杰平方積極拓展車載功率晶片、車載信號鏈、車載模擬晶片等前沿產品，並按照主機廠商需求進行定制開發，包含高邊驅動（HSD）、低邊驅動（LSD）、半橋驅動（HBD）、同步降壓轉換器（DCDC）。

杰平方有效整合國際技術經驗和本土資源，深刻把握本土客戶定制化需求，與國內外數家汽車產業鏈知名企業深入合作，提供高品質交付方案。核心團隊晶片設計及半導體工藝造詣精深，產能保障、車規級產品認證、供應鏈管理能力紮實，具備研-產-用一體化的系統化優勢。秉持“誠信、創新、以人為本”的精神，杰平方憑藉自身優勢設計能力、對產業的獨到理解，致力實現中國本土車載晶片的自主可控，並且在第三代半導體碳化矽器件生產領域成為世界級的領先企業（IDM 模式）。

杰平方已獲得多家頂尖投資機構、著名汽車零部件生產企業、通訊技術頭部企業的投資與支持。

更多有關杰平方半導體（上海）有限公司的詳情，請瀏覽 [www.j2semi.com](http://www.j2semi.com)。

#### **傳媒查詢，請聯絡：**

##### **香港科技園公司**

溫安怡

電話：+852 2629 2329

電郵：[angela.wan@hkstp.org](mailto:angela.wan@hkstp.org)

##### **愛德曼國際公關公司**

黃嘉琪

電話：+852 3756 8623 / 6986 5822

電郵：[June.Wong@edelman.com](mailto:June.Wong@edelman.com) /  
[Edelmanhkstppr@edelman.com](mailto:Edelmanhkstppr@edelman.com)

##### **杰平方半導體（上海）有限公司**

邱晨亮

電話：+8621 3875 5958

電郵：[J2adhr@j2semi.com](mailto:J2adhr@j2semi.com)